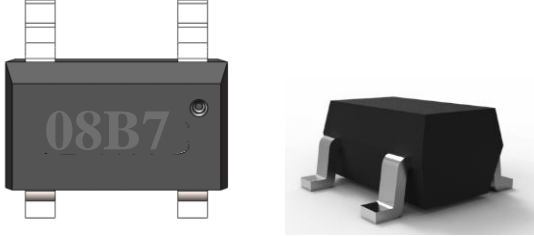
 <p>symbol</p> 	<h3>FEATURES</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 反向电压: 50-1000V</li> <li>● 正向电流: 0.6A</li> <li>● 玻璃钝化芯片</li> <li>● 优异的正向浪涌性能</li> <li>● 低正向压降</li> <li>● 高温焊接保证: 260°C/10S</li> <li>● 引线 and 管体符合 RoHS 标准</li> </ul> <h3>机械数据</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 封装: IBS</li> <li>● 极性: 按照激光印字</li> <li>● 环氧树脂 UL 易燃等级: 94V-0</li> <li>● 安装位置: 任意</li> </ul>
---	---

### 极限值和温度特性 (TA=25°C, 除非另有说明)

参数	符号	IB05S	IB1S	IB2S	IB4S	IB6S	IB8S	IB10S	单位
最大可重复峰值反向电压	$V_{RRM}$	50	100	200	400	600	800	1000	V
最大均方根电压	$V_{RMS}$	35	70	140	280	420	560	700	V
最大直流阻断电压	$V_{DC}$	50	100	200	400	600	800	1000	V
最大正向平均整流电流 @Ta=40°C	$I_{AV}$	0.6							A
正向不重复浪涌电流8.3ms单一正弦半波	$I_{FSM}$	25							A
单位时间内承受的最大电流	$I^2t$	2.59							A <sup>2</sup> s
最大正向电压 @If=0.5A	$V_F$	1.0							V
最大反向电流 @TA=25°C	$I_R$	5							uA
最大反向电流 @TA=125°C		500							
典型结电容 @VR=4.0V, f=1MHZ	$C_J$	13							PF
典型热阻	$R_{\theta JA}$	90							°C/W
工作结温和存储温度	$T_J, T_{stg}$	-55 to +150							°C

### 特性曲线 (TA=25°C,除非另有说明)

FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

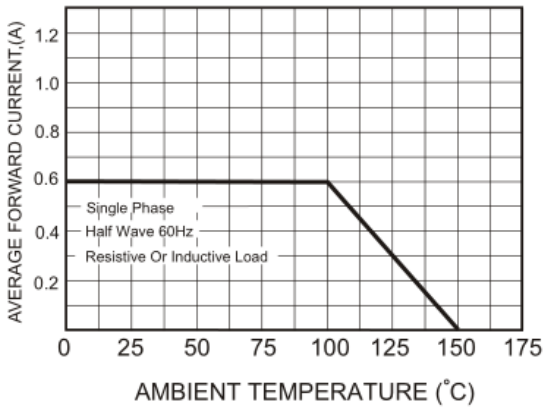


FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

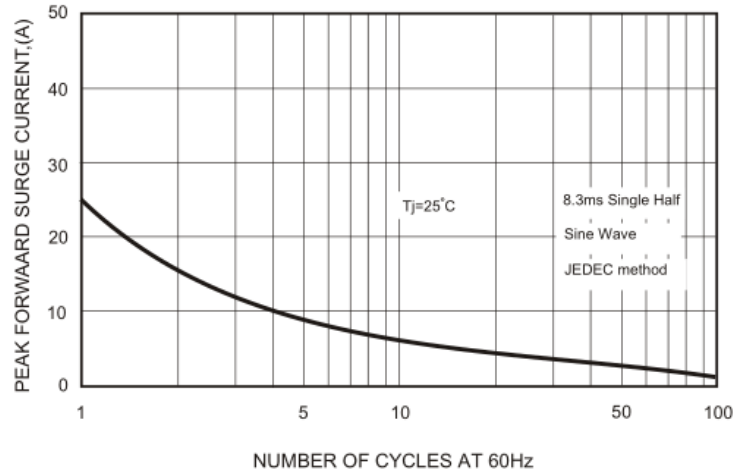


FIG.3-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS

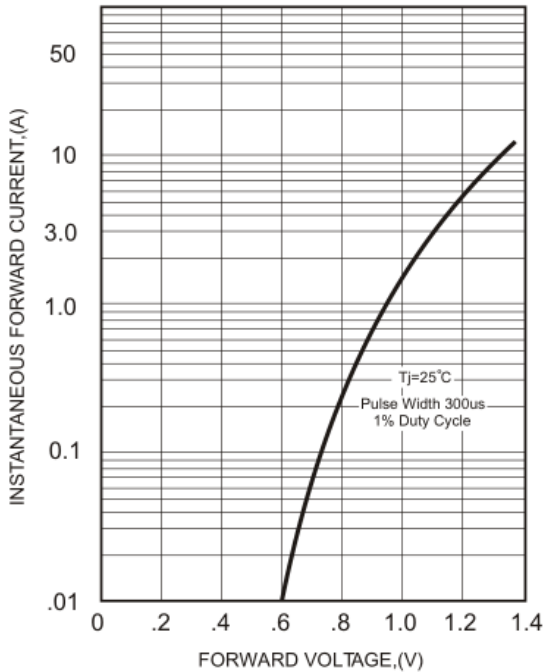
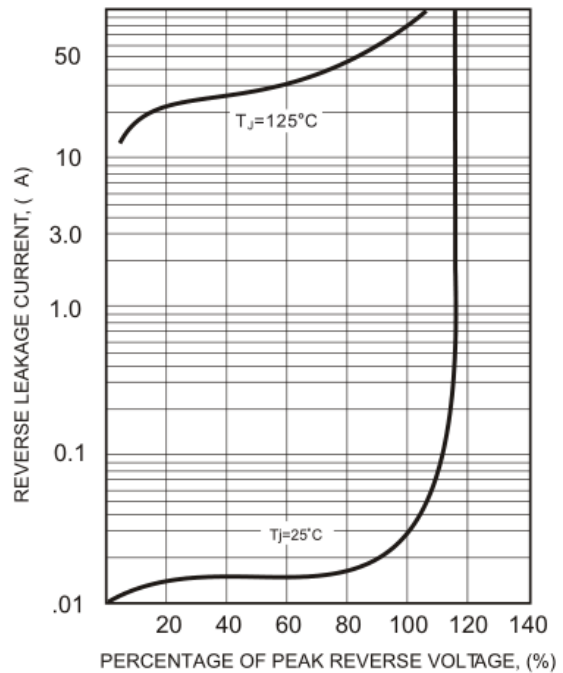
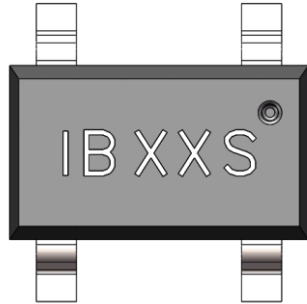


FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



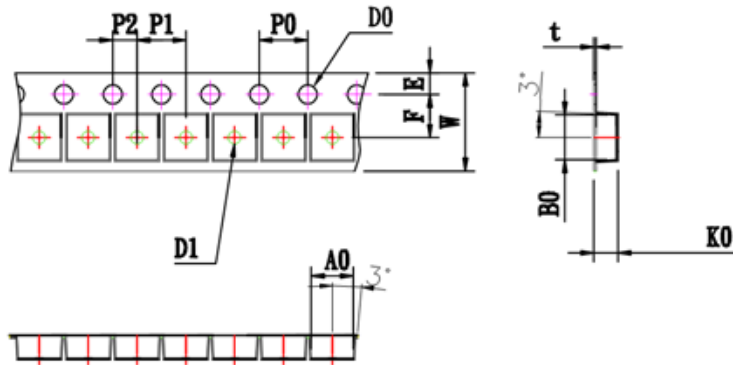
### 印字信息



脚位	描述
1	OUTPUT(+)
2	OUTPUT(-)
3	INPUT(~)
4	INPUT(~)

IBXXS: 型号丝印

### 载带尺寸



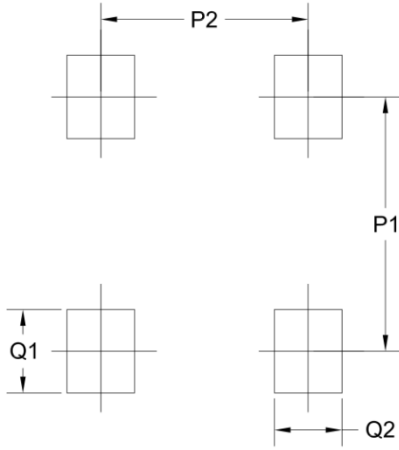
Symbol	A0	B0	K0	D0	D1	P0	P1
Spec	3.45±0.10	3.72±0.10	1.90±0.10	1.55±0.10	1.08±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10
Symbol	W	E	F	P2	10*P0	t	t1
Spec	8.00±0.10	1.75±0.10	3.50±0.10	2.00±0.10	40.00±0.10	0.21±0.02	0.05以上

K0: 不含底厚

### 包装方式与数量

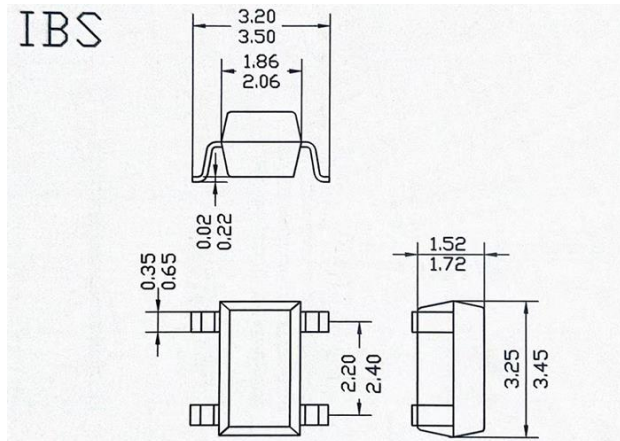
封装	包装方式	包装数量		
		IBS	13寸卷盘	10K/盘

### 焊盘布局建议



参数	Min /mm
P1	2.8
P2	2.3
Q1	0.95
Q2	0.75

### 封装机械数据



封装: IBS 单位: mm